

令和5年8月24日

関係各位

(一社) 日本実装技術振興協会
会長 嶋田 勇三

第222回定例講演会のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、日本実装技術振興協会の第222回定例講演会の内容が決まりましたのでお知らせいたします。

今回も会場とWEB会議システム（Zoom ウェビナー）を利用したハイブリッド開催となります。

ご多忙の中恐縮ではございますが、万障お繰り合わせの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。
ホームページでも同定例講演会の情報を配信します。

敬具

記

1. 開催日時：令和5年9月21日（木）定例講演会 13：00～16：30

2. 開催方式：ハイブリッド方式

【川崎市産業振興会館第4会議室（会員のみ）+WEB会議システム「Zoom ウェビナー」】

（Zoom参加を申し込みされた方には後日、招待メールをお送りします）

川崎市産業振興会館：〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66番地20

<https://kawasaki-sanshinkaikan.jp/>

3. プログラム：“実装技術の肝“配線・接合要素技術”の新潮流”

13:00～13:50 プログラムテーマ	『グラビアオフセット印刷法による微細はんだバンプの形成』 株式会社小森コーポレーション PE事業本部 PE開発課 課長 池田 英樹 氏 講演内容：高精度&微細印刷を得意とするグラビアオフセット印刷法を用いて、はんだペーストによるマイクロはんだバンプの形成について報告する。本技術確立の為 Type6 と Type9 のはんだペーストをグラビアオフセット印刷向けに開発し、最小φ6μm までのバンプ印刷に成功している。同社では、本印刷技術を昨今小型化や薄膜化が急速に進んでいる電子デバイスや半導体の分野で利用できることを目指し研究に励んでいる。
13:50～14:40 プログラムテーマ	『B5G/6G およびパッケージ基板向けプラズマ表面改質による難接着材料の直接接合』 株式会社電子技研 開発事業責任者 開発部部长 古川 勝紀 氏 講演内容：同社はプラズマを用いた各種材料の表面改質技術を開発しており、独自の官能基付与技術（同社特許技術）により、難接着材料が非粗化・接着剤レスで直接接着する技術（PTFE/Cu:7N/cm, LCP/Cu:6N/cm, 硝子/Cu=4N/cm, PCTFE/Al=10N/cm 等）、接着剤使用時の接着強度を高める（未処理比較時接着強度 4 倍）表面処理技術を開発し、各種フィルム、プリント基板、表面処理・加工、電池関連メーカーに採用され、各メーカーで実用化にむけ開発が推進している。B5G/6G 回路基板には低誘電樹脂使用及び平滑な界面で銅回路を形成する必要があるが、低誘電樹脂は接着性に乏しく、投锚効果や接着剤に用いず密着性を確保する技術は確立されていない。同社では、減圧プラズマを用いた表面改質により基材表面に強固に結合した官能基（-NH 基）を形成することにより、低誘電樹脂を非粗化・接着剤レスでの直接銅めっきおよび銅箔/低誘電樹脂を直接接着する技術及び表面処理装置を開発した。この技術・装置を用いれば、77GHz 以上の B5G/6G に活用できる多層フレキシブル基板作成が可能になる。また、高密度実装で処理速度を向上させるための次世代半導体パッケージ（パッケージ基板）が注目され始めている。基材としてはガラスが有望であるが、ガラスへの銅めっきはプライマー等種々の方法が検討されているが、信頼性を含め方法は確立できていない。ガラス基板への直接銅めっきにも同社表面改質技術で実現できており、信頼性を含め適用できるかの検討を開始している。本講演では、本表面改質の原理から実例及び信頼性までを解説し、各企業の今後のビジネス戦略を立てて行く為の参考情報を提供する。
14:40～15:00	－ 休 憩 －
15:00～15：30 プログラムテーマ	『電気印刷の紹介』 株式会社電気印刷研究所 代表取締役 三谷 雄二 氏 講演内容：新しい印刷技術として開発した「電気印刷」技術を紹介する。電気印刷とは、フィルムに静電潜像を印刷する技術である。トナーで現像して、そのトナーに銅をめっきすると電気回路が形成できる。10μm の細線、3D 曲面回路ができる。

15:30～16:20 ④プログラムテーマ	『新規耐熱性 IMC 接合材の開発と応用』 有限会社ナブラ 技術顧問 池田 博明 氏 講演内容：①開発の背景、②Sn-Cu IMC 活用上の課題と対策、③Sn-Cu IMC 骨格構造の形成技術、④三元系(Sn-Cu-Ni) IMC 接合材及び四元系(Sn-Cu-Ni-Sb) IMC 接合材の特徴、⑤IMC 接合材の信頼性、⑥IMC 接合材のTIM 応用、⑦今後の展開。
16:20～16:30	『トークセッション』 講師の皆様と参加者の皆様とで、意見交換を行う時間を設けます。

4. 参加費

会 員：無料 企業正会員は1社3名まで（Web 会議特例：3名を超える参加者については事務局にお問い合わせください）。また、同じ名前とメールアドレスで複数の方が入室した場合、システム上、同一人物が入室した人数分表示されます。1 登録1名様のご利用でお申込みください。
会員外：22,000 円/人（不課税）（お申し込み後、請求書をお送りします）

5. 参加申し込み

会 員：会員は別途メールでお送りしているご出欠連絡用紙（企業正会員には登録代表者（連絡担当者）にお送りしています）にご記入の上、E-mailにてお申し込みいただけますようお願いいたします。

※今回、会場と Zoom ウェビナーのハイブリッド方式での開催となります。お申し込みの際は、参加者それぞれ、どちらの方式での参加をご希望か記載してください。

※会場の都合で入場できる人数に限られます。また、会場参加者が多い場合、Zoom 参加にご変更をお願いすることがございますのでご了承下さい。

※会場での懇親会は行いませんが、名刺交換などの時間を設ける予定です。

会員外：参加形式は Zoom ウェビナーのみになります。ホームページのお問い合わせフォーム

(<https://www.j-jisso.org/p/contact.html>) より「お問い合わせ内容」の項目に第 222 回定例講演会参加希望の旨を記載してご連絡ください。申込者と参加者が異なる場合、参加者のお名前と E-mail アドレスもご記入ください。

申込締切日：会 員 令和 5 年 9 月 13 日（水）

会員外 令和 5 年 9 月 6 日（水）

※講演 2 日前までに、ご参加者各人に招待メールをお送りしますので、ご参加者全員の氏名・メールアドレスをご連絡ください。また、Zoom ウェビナーに参加される際には、ご連絡いただきましたメールアドレス・参加者氏名でログインするようお願いいたします。セキュリティの関係上、名簿と合致しない場合、Zoom 定例講演会から退場していただく場合がございます。参加者が変更する場合はご連絡ください。

※講演資料は、講演日 1 週間前に郵便で発送させていただきます（企業正会員は登録代表者（連絡担当者）にお送りします）。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さいませますようお願い致します。

事務局：一般社団法人 日本実装技術振興協会事務局 担当/相良(サガラ)・太田
携帯：090-5403-1147 (相良)、090-5301-9467 (太田)
E-mail: j.jisso.org@gmail.com URL: <http://www.j-jisso.org/index.html>